



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、Embedded World 2018において VIA スマート認識プラットフォームを発表 公共の安全と消費者の利便性を高めるための顔認識システムの開発をスピードアップ

2018年2月26日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、2月27日から3月1日まで、ドイツ・ニュルンベルグで開催される Embedded World 2018において、高性能コンピュータビジョンシステムとキオスクで構成される VIA スマート認識プラットフォームを発表いたします。VIA ブースは、ニュルンベルク・エキシビション・センターのホール2 #2-551です。

VIA スマート認識プラットフォームは、Qualcomm[®] Snapdragon[™] 820 クアッドコアプロセッサが有する最先端ビデオ、グラフィックス、コンピューティング機能と、幅広いカメラとディスプレイの統合、I/O 機能の有効化、ワイヤレス接続オプションを組み合わせ、高度なセキュリティ、監視、交通監視、建物管理、消費者エンゲージメントシステムアプリケーションなどを構築するための柔軟なパスを提供します。



感情、年齢や性別の検出、人数のカウントや追跡など、オブジェクトと顔の認識をサポートすることで、買い物客にパーソナライズされた広告やプロモーションを提供する小売りサイネージキオスクへ誘導するためのスタッフや訪問者に対するオフィスのアクセス制御や追跡など、特定の導入要件と展開要件を満たすよう、プラットフォームを迅速にカスタマイズすることができます。また、が含まれます。顔認証とオブジェクト認識の速度と精度は、プラットフォームの高度な AI アルゴリズムによって保証されています。

VIA、Embedded World 2018において VIA スマート認識プラットフォームを発表

2/3

「顔認証やオブジェクト認識などのコンピュータビジョン技術は、空港のチェックインカウンターや保安検査から、スーパー・マーケットのセルフサービスキオスクや支払い認証システムまで、公共の安全と利便性を向上させる重要なツールとなっています」と VIA 国際マーケティング VP のリチャード・ブラウンは語ります。「VIA スマート認識プラットフォームは、革新的な新しい顧客サービスと経験を提供するために、これらの最先端技術を活用したオーダーメードシステムの開発と導入をスピードアップします」

VIA スマート認識プラットフォーム

VIA スマート認識プラットフォームは、Qualcomm Snapdragon 820 エンベデッドプラットフォームを搭載した VIA SOM-9X20 システムモジュールをベースにしています。わずか 8.2 × 4.5cm のこのモジュールは、64GB の eMMC フラッシュメモリと 4GB の LPDDR4 SDRAM を搭載し、MXM 3.0 314 ピンコネクタを通じて、USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、SDIO、PCIe、MIPI CSI、MIPI DSI などを含む豊富な I/O およびディスプレイ拡張オプションを提供します。また、UART、I2C、SPI、GPIO 用の多機能ピンも備えています。さらに、GPS、BT 4.1、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac などの高度なワイヤレス接続機能を、2 つのアンテナコネクタを備えた統合コンボモジュールを通じて提供します。

SOMDB2 マルチ I/O キャリアボードは、システム開発を高速化するためにもご利用いただけます。お客様は、VIA の幅広い技術サポートと設計支援サービスを利用して、独自のカスタムベースボードを開発することもできます。

VIA スマート認識プラットフォームには、Android 7.1.1 とシステムクラッシュから保護するウォッチドッグタイマー(WDT)、GPIO アクセス、オートパワーオンのための RTC などの API とサンプルアプリを含む VIA Smart ETK(組み込みツールキット)を搭載した BSP が付属しています。また、Linux Kernel 3.18.44 をサポートする BSP も開発中です。

さらに、実用化までの時間を短縮し、開発コストを最小限に抑えるハードウェアおよびソフトウェアカスタマイズサービスのフルセットも利用できます。

Embedded World 2018 における VIA ソリューションの詳細については、
<http://www.viatech.com/en/about/events-2018/embedded-world-2018/> をご参照ください。

本リリースに関する画像については、下記 URL をご覧ください：

<https://www.viagallery.com/via-embedded-world-2018/>

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットホームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

VIA、Embedded World 2018において
VIA スマート認識プラットフォームを発表

3/3

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。